

Integra® 系列：型号 508.3

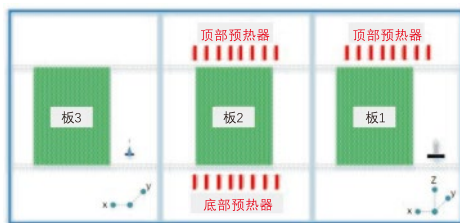
508.3S、508.3PD或508.3PD的2阶段配置选择性焊接系统

特点和优势

- 三个工作区，可实现助焊剂涂覆、预热和焊接同时进行，提高生产量和最大预热能力
- 可选择单双喷助焊剂涂覆机和焊锡锅，适用于并行加工或独立的双重加工模式
- 并行加工显著提高机器产量，而双重加工扩大焊接灵活性
- 2阶段配置，可焊接2块单独的电路板用输送机在线，无需镶板或工具
- 全钛焊锡锅与所有焊料合金兼容，方便维护，无需使用工具

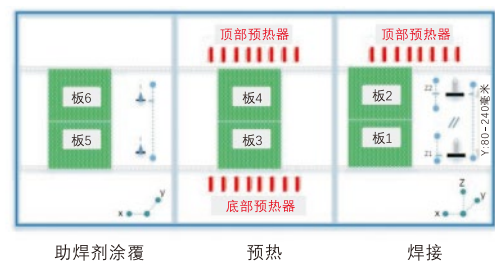
Integra® 508.3是一种多工位选择性焊接系统，专为大批量应用而设计，可实现产能最大化。Integra® 508.3提供灵活的配置，可以焊接大小为508×508毫米(20.0×20.0 英寸)的印刷电路板。

多功能性。 客户可在Integra® 508.3的三种不同型号之间进行选择，以满足广泛的选择性焊接要求。Integra® 508.3S配置单头助焊剂涂覆机和焊锡锅，提供单板处理。



Integra® 508.3S配置

配置双喷助焊剂涂覆机和双焊锡锅时，Integra® 508.3PD提供两种不同的使用模式，可在同一焊接工位使用两个焊锡喷嘴或同时处理拼板中的两个单板。Integra® 508.3PD可以同时处理多达6块电路板。在并行加工模式下，该系统可以同时两块印刷电路板进行喷助焊剂和焊接，从而使机器生产率加倍。



Integra® 508.3PD配置

Integra® 508.3pd 2seg配置双头助焊剂涂覆机和焊锡锅，可在平行模式下用传送带在线焊接两块单板。可对两个印刷电路板连续焊接，而无需电路板在一个拼板、托盘化或使用工具。

价值。 素以创新享誉业内的Nordson SELECT提供全方位的过程解决方案，确保了最大的投资回报率和较低的拥有成本。从最初的过程开发到全面的生产，您都能从我们经验丰富的全球设计、应用开发和技术服务网络获得支持。

Integra® 508.3 特点

Integra® 508.3是一款配置完整、与SMEMA兼容的选择性焊接平台，为许多条件苛刻的通孔和SMT混合技术焊接应用提供可靠的且成本高效的解决方案，包括：

- 双面线路板的通孔部件和SMT部件
- 通孔部件的选择性焊接和微波焊接
- 多焊料合金焊接，无需更换焊锡锅

并行或双重加工模式 采用双助焊剂涂覆机和焊锡锅，适用于同时或独立焊接



并行模式可同时焊接两块电路板，双重模式允许一次使用多个尺寸喷嘴



2阶段配置，可焊接两块单独的板用传送带在线，无需镶板或工具

三个工作区，可实现助焊剂涂覆、预热和焊接同时进行，提高机器产量

全钛焊锡锅和泵组件兼容所有焊料合金

单或双助焊剂涂覆机和焊锡锅，提高生产率和焊接灵活性



喷嘴距离可自动调节，范围为80-240毫米

SMEMA链条输送机，宽度自动调节

标准功能

三个工作区，配备同时进行焊剂涂覆和预热的独立区以及单个选择性焊接工位(508.3S)

具有PCB找平找正功能的SMEMA链式输送机，输送机宽度可自动调节

MicroDrop喷助焊剂涂覆机

助焊剂液面监测系统

全表面底部红外线预热

全钛焊锡锅和泵组件

快换式磁耦合焊嘴

自动焊锡液位监测

自动锡波高度监测

加热氮气惰化系统

过程观察相机

PhotoScan编辑器和机器控制软件

-方便的“点击式”编程

-远程机器控制

-远程机器维护

-网络和FIS功能

TFT监控器

其他配置

双MicroDrop下喷助焊剂涂覆机以及双焊锡锅，用于并行或双重焊接模式(508.3PD)

双MicroDrop下喷助焊剂涂覆机以及双焊锡锅，用于并行或双重焊接模式或两块并联电路板连续焊接(508.3PD 2seg)

可选功能

全自动基准校对和电路板测绘

用于助焊剂涂覆控制的过程中闭环式助焊剂验证系统

全表面顶部红外线预热

闭环高温计控制

电路板翘曲感测系统

双过程观察相机和第二监控器

自动焊丝送料系统

自动焊锡料位感测系统

波高控制感测系统

自动焊嘴清洁系统

AOI焊缝检测系统

具有跟踪所有过程参数功能的数据记录系统，条码阅读器

技术参数: Integra®508.3

运动系统

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Z轴精确度 | ±1.00 微米 (0.004 英寸) |
| Z轴重复精度 ⁽¹⁾ : | ± 50 微米 (0.002 英寸), 3 sigma |
| Z轴速度: | 0.05 米/秒峰值 (2 英寸/秒) |
| X-Y轴精确度 | ±1.00 微米 (0.004 英寸) |
| X-Y轴重复精度 ⁽¹⁾ : | ± 50 微米 (0.002 英寸), 3 sigma |
| X-Y轴速度: | 0.2 米/秒峰值 (8 英寸/秒) |

计算机

搭载Windows® 操作系统的PC

软件

PhotoScan “点 击” 编程编辑器和机器控制软件

焊锡炉容量和重量

| |
|---|
| 容量 ⁽²⁾ : 约 12.0 千克 (26.4 磅) |
| 锡铅焊料与焊锡锅和泵组的总重量 ⁽²⁾ : 约 22.4 千克 (49.2 磅) |
| 无铅焊料与焊锡锅和泵组的总重量 ⁽²⁾ : 约 19.7 千克 (43.3 磅) |
| 最高温度: 320°C |

可焊面积(X-Y)

单一、并行或双重操作模式^(3, 4):
最大 508 x 508 毫米 (20.0 x 20.0 英寸)
最小 50 x 50 毫米 (2.0 x 2.0 英寸)

预热

可选顶部预热1.5 千瓦至12.0 千瓦
可选底部预热1.5 千瓦至12.0 千瓦

电路板处理能力

508.3S和508.3PD^(3, 4):
最大电路板尺寸: 508 x 508 毫米 (20.0 x 20.0 英寸)
最小电路板尺寸: 50 x 50 毫米 (2.0 x 2.0 英寸)

输送机

最大板/载体长度: 508 毫米(20.0 英寸)
最小板/载体长度: 50 毫米(2.0 英寸)
最大板/载体宽度: 508 毫米(20.0 英寸)
最小板/载体宽度⁽⁴⁾: 50 毫米(2.0 英寸)
最大板/载体厚度: 15.2 毫米(0.6 英寸)
最大板上间隙: 120 毫米(4.7 英寸)
最大板下间隙: 40 毫米(1.5 英寸)
边部间隙⁽⁵⁾: 3 毫米(0.12 英寸), EDGE输送机, 轨道上安装夹具
输送高度⁽⁶⁾: 符合SMEMA输送机高度标准; 高度可调节, 范围: 940-965毫米(37.0 - 38.0 英寸)从地板到输送板底部
载重能力⁽⁷⁾: 7.5 千克(16.5 磅)
操作模式: 自动(SMEMA)、手动或传递

设施要求

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 系统占地面积 | 508.3S/508.3PD | 3200 x 1700 毫米(126.0 x 66.9 英寸) |
| | 508.3PD 2seg | 4300 x 1700 毫米(169.3 x 66.9 英寸) |
| 压缩空气: | | 最小6bar, 最大8bar。 |
| 电源(市电) ⁽⁸⁾ : | 508.3S | 400/480VAC, 50-60 Hz, 3相, 23 kW, 33 A 无需预热, 或者 29 kW, 42 A 预热 |
| | 508.3PD | 400/480VAC, 50-60 Hz, 3相, 26 kW, 38 A 无需预热, 或者 32 kW, 46 A 预热 |
| | 508.3PD 2seg | 400/480VAC, 50-60 Hz, 3相, 29 kW, 42 A, 无需预热, 或者 36 kW, 50 A, 需预热 |
| 氮: | | 99.99% (4.0) 纯度, 4-6 bar, 1.3 立方米/小时 (单锅), 2.6 立方米/小时 (双锅) |
| 通风: | | 后部300立方米/小时(180SCFM), 两个管道直径100 毫米 (4.0 英寸) |
| 系统重量 ^(9,10) : | | 1500 千克 (3300 磅) |

- (1)重复性以全速(系统额定速度)测量。
- (2)焊锡锅和泵组件的焊接能力和总重量因焊锡合金而异。
- (3)并行、双重模式或2阶段连续模式下工作时, 工作面积降低。
- (4)有关更小或更大的板/载体信息, 请联系工厂。
- (5)EDGE输送机符合SMEMA标准。
- (6)900毫米(35.4 英寸)非SMEMA输送机高度可根据要求提供。
- (7)任何时刻输送机上所有零件的总重量。请联系工厂, 了解更大的载重能力要求。
- (8)电源因配置而异。
- (9)系统重量因配置而异。
- (10)取决于配置。可选择其他配置。联系Nordson SELECT。

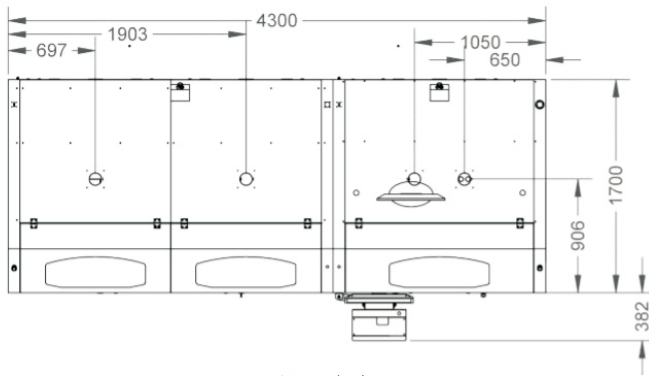
Windows是Microsoft Corporation在美国和其他国家/地区的注册商标。

标准合规性

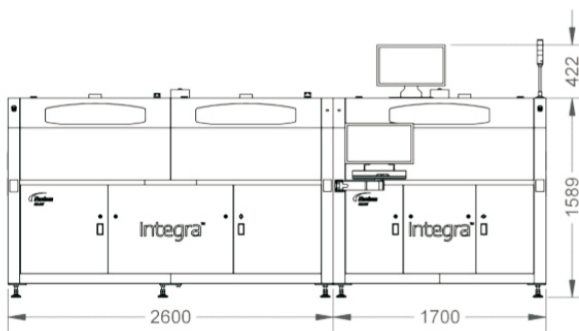
SMEMA、CE

可提供其他选项: 联系Nordson SELECT了解更多信息。

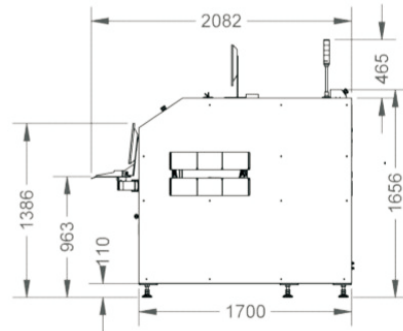
Integra® 508.3PD 2seg



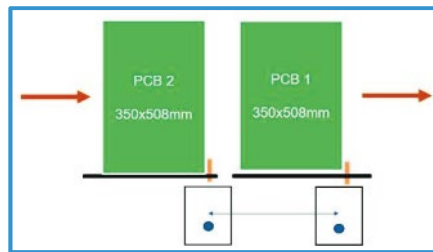
顶视图(毫米)



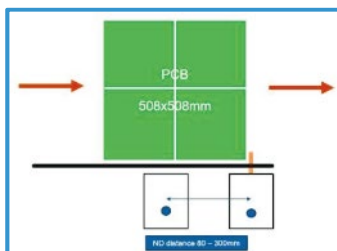
前视图(毫米)



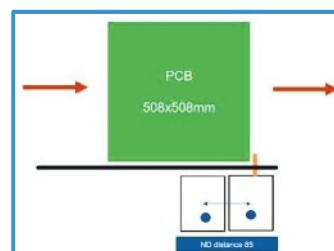
侧视图(毫米)



Integra® 508.3PD 2seg以顺序模式焊接两块单独的电路板



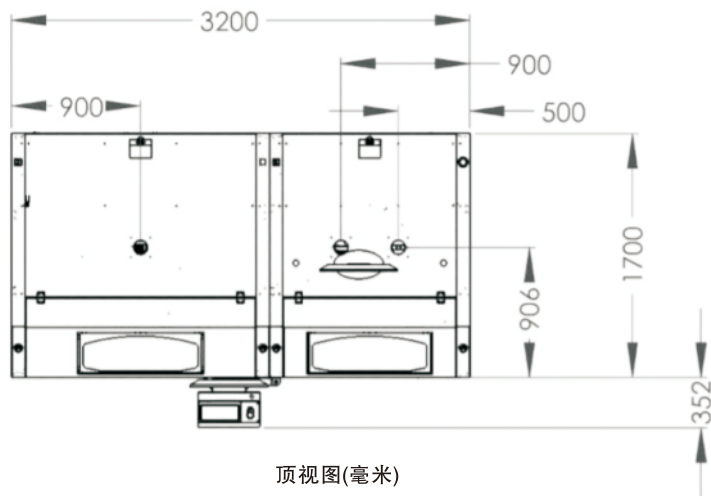
Integra® 508.3PD 2seg
使用双喷嘴焊接镶板



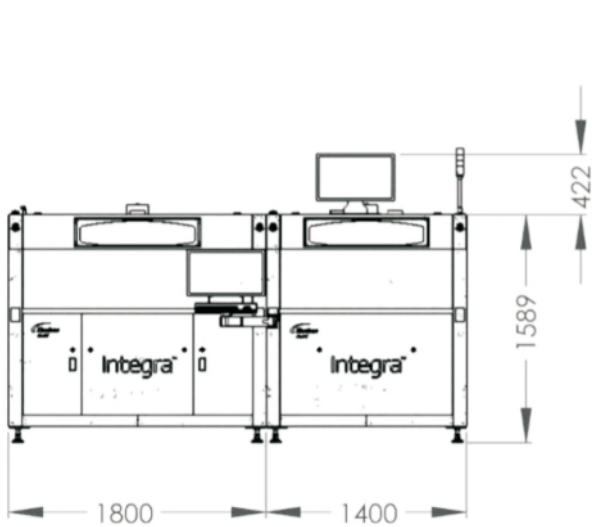
Integra® 508.3PD 2seg使用
小喷嘴和大喷嘴焊接电路板

Integra® 508.3S和508.3PD

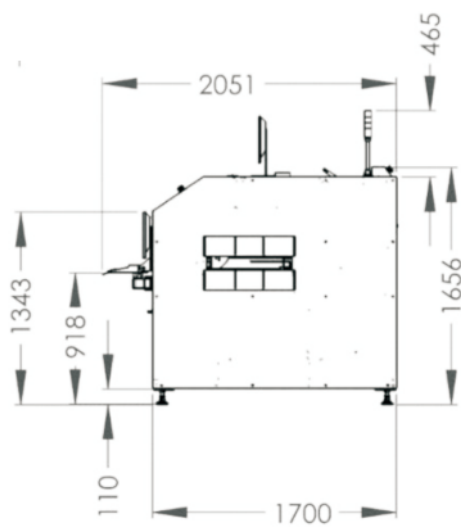
尺寸(单位: 毫米)



顶视图(毫米)



前视图(毫米)



侧视图(毫米)

香港总公司 Hong Kong Head Office ☎ (852)29183718

✉ sales@americantec.com

深圳公司 (ATS中心)
Shenzhen Company (ATS Centre)
☎ (86)755 61350555

新加坡公司
Singapore Company
☎ (65) 62356163

印度公司
India Company
☎ (91) 1204367122

成都分公司
Chengdu Branch Office
☎ (86) 28 86083808

苏州分公司 (ATS中心)
Suzhou Branch Office (ATS Centre)
☎ (86) 512 67618859

上海分公司
Shanghai Branch Office
☎ (86) 21 62194580

天津分公司
Tianjin Branch Office
☎ (86) 22 83850410

越南代表处
Vietnam Rep. Office
☎ (84) 984898809



了解更多
关注美亚特公众号

技术热线: 4008822331

www.americantec.com

AMTEC.V0002022APR

